

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年7月12日(2007.7.12)

【公表番号】特表2003-521119(P2003-521119A)

【公表日】平成15年7月8日(2003.7.8)

【出願番号】特願2001-555112(P2001-555112)

【国際特許分類】

H 01 L 23/12 (2006.01)

【F I】

H 01 L 23/12

B

【手続補正書】

【提出日】平成19年5月23日(2007.5.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

電子パッケージであって、

第1面と第2面とを有し、複数の相互接続パッドを画定するようにパターニングされる導電トレース層と、

該導電トレース層の該第1面に取付けられる誘電体層と、

第1導電層と、第2導電層と、該第1導電層と該第2導電層との間に配置される誘電体材料の層と、を有し、該第1導電層が該導電トレース層の該第2面に取付けられるコンデンサと、

該コンデンサの該第1導電層と該誘電体材料層とを通って延在する複数の相互接続領域と、

該コンデンサの該導電層の各々と該相互接続パッドの対応するセットとの間に接続された相互接続部材であって、該コンデンサの該第1導電層が該相互接続パッドの第1セットに電気的に接続され、該コンデンサの該第2導電層が該相互接続パッドの第2セットに電気的に接続され、相互接続パッドの該第2セットに対応する相互接続部材が、該相互接続領域のうちの1つを通って延在する、相互接続部材と、

を具備することを特徴とする電子パッケージ。

【請求項2】

前記コンデンサの前記第2導電層を支持する電気的導電補強部材と、前記誘電体層、前記導電トレース層および該コンデンサを通って延在する機器収容領域と、をさらに具備し、該補強部材の該機器収容領域に取付けられる電子機器をさらに具備することを特徴とする、請求項1記載の電子パッケージ。

【請求項3】

前記コンデンサの前記誘電体材料が、5 μmから30 μmまでの厚さを有することを特徴とする、請求項1又は2のいずれか1項に記載の電子パッケージ。

【請求項4】

前記誘電体材料が、高誘電率粒子と混合された非導電重合体から作製され、該高誘電率粒子が、チタン酸バリウム、チタン酸バリウムストロンチウム、酸化チタン、チタン酸ジルコン鉛および酸化タンタルからなるグループから選択された材料から形成されていることを特徴とする、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の電子パッケージ。

【請求項5】

電子パッケージであって、

第1面と第2面とを有し、複数の相互接続パッドを画定するようにパターニングされた導電トレース層と、

該導電トレース層の該第1面に取付けられたフレキシブル誘電体層と、

第1導電層と、第2導電層と、該第1導電層と該第2導電層との間に配置された誘電体材料の層と、を有し、該第1導電層が該導電トレース層の該第2面に取付けられるフレキシブルコンデンサと、

該コンデンサの該第1導電層と該誘電体材料層とを通って延在する複数の相互接続領域と、

該コンデンサの該導電層の各々と該相互接続パッドの対応するセットとの間に接続された相互接続部材であって、該コンデンサの該第1導電層が該相互接続パッドの第1セットに電気的に接続され、該コンデンサの該第2導電層が該相互接続パッドの第2セットに電気的に接続され、相互接続パッドの該第2セットに対応する相互接続部材が、該相互接続領域のうちの1つを通って延在する、相互接続部材と、

該相互接続パッドの各々に隣接する該誘電体層を通って延在する孔と、

該コンデンサの該第2導電層に隣接して取付けられる補強部材と、

該誘電体層、該導電トレース層および該コンデンサを通って形成される機器収容領域と、
、
を具備することを特徴とする電子パッケージ。